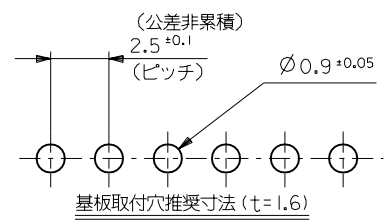
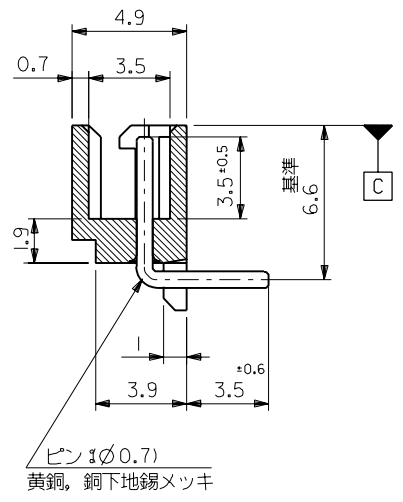
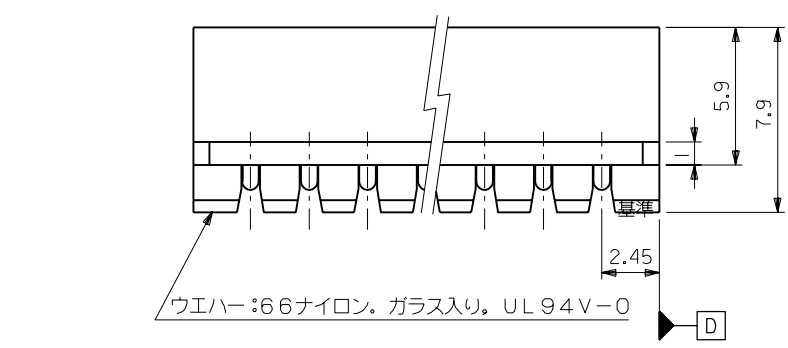
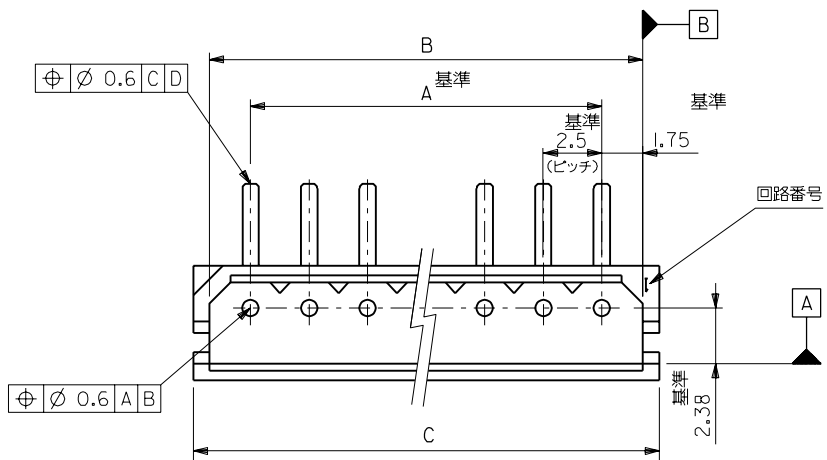


EDP NO. 22-05-7**5
ENG. NO. SD-5268-NA
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)

NOTE:
1. 嵌合相手: 5264 シリーズ

39.9	38.5	35	22-05-7155	5268-15A	15
37.4	36	32.5	-7145	-14A	14
34.9	33.5	30	-7135	-13A	13
32.4	31	27.5	-7125	-12A	12
29.9	28.5	25	-7115	-11A	11
27.4	26	22.5	-7105	-10A	10
24.9	23.5	20	-7095	-09A	9
22.4	21	17.5	-7085	-08A	8
19.9	18.5	15	-7075	-07A	7
17.4	16	12.5	-7065	-06A	6
14.9	13.5	10	-7055	-05A	5
12.4	11	7.5	-7045	-04A	4
9.9	8.5	5	-7035	-03A	3
7.4	6	2.5	22-05-7025	5268-02A	2
C	B	A	EDP NO.	ENG.NO.	種数

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	+0.3				
10以上 30未滿 UNDER	+0.25	C	再作図及び変更 (J10590)	K.H.	9/17/26
10未滿 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

材料 MATERIAL	— / —
仕上げ FINISH	— / —
適用電線範囲 WIRE RANGE	— / —
被覆外径 INS. RANGE	— / —
DRAWN BY K.TOJO '91/7/26	CHK'D BY '92/08/31
APP'D BY M.ENOMOTO	H.H. 尺度 SCALE 5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO. 22-05-7**5	
ENG. NO. SD-5268-NA	REV C
TITLE 名称 2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y 90° BEND	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8